

第10期

株主通信

2014年4月1日～2015年3月31日

第10期 定時株主総会決議ご通知

特集

九州事業所から見る
システムLSI事業の
テストビジネスの取り組み

- 経営理念
- ごあいさつ
- 連結決算ハイライト
- TOPICS
- NEWS
- 第10期 定時株主総会決議ご通知
- 会社情報／株式情報

経営理念

常に、チャレンジ精神と誇りをもってビジネスに取り組み、技術を磨き、生産の効率化を進め、世界中のお客様が心から満足し信頼できるパートナーとして、新たな価値創造に貢献します。

ごあいさつ



みなさまにおかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2014年度の当社グループが属する半導体市場は、スマートフォン、車載、産業機器向けなどを中心に堅調に推移しました。2014年暦年ベースでは前年に引き続き、過去最高の市場規模になり、今後も着実な成長が期待されております。

このような状況の中、当社では台湾子会社との連携を強化し、継続して高品質・低コストなサービスの提供を図るとともに、事業構造の改善やコスト削減に取り組んでまいりました。その結果、2014年度の当社グループの業績は、売上高は前年度から1.7%減の21,303百万円、営業利益は前年度から58.7%増の1,329百万円、経常利益も同66.7%増の1,306百万円となりました。当期純利益につきましては、特別損失として青梅事業所の事業構造改善費用951百万円を計上したことなどから477百万円の損失となりましたが、事業構造改善の成果として、第4四半期においてシステムLSI事業が黒字に転換しております。

なお、配当金につきましては、繰越利益剰余金が欠損の状況であることから、残念ながら無配とさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

当社グループが対処すべき課題については、以下の通り施策を実行してまいります。

一つ目の課題は「新たな市場の開拓」です。当社グループは、特定の顧客や製品分野への依存度が高いことから、新規顧客・分野への展開を進めてまいります。既に日本及び台湾の双方でISO/TS16949*1の認証を取得しており、車載向け半導体のテスト受託を強化してまいります。また、将来的に生産量の増加が期待されるイメージセンサ向けのテスト受託の強化に加え、テストプログラムの作成などテスト受託に関連したビジネスも強化してまいります。

さらに、新たなビジネスとして、顔認証ソフトウェア「TeraFaces™」や、画像処理技術を応用した組込みソフトウェアの開発、販売に注力してまいります。評価SDK*2を使用した、お客様による実機での評価/検証も始まっており、早期の事業化を目指してまいります。また、長期的な目標として生体信号を用いたヒューマンインターフェース技術の研究を進めてまいります。

もう一つの課題は「更なる生産性の向上」です。当社グループの特徴として、設備の固定費負担が大きく、稼働状況が収益に大きく影響いたします。設備の稼働率の向上に向けた営業活動の強化や、グループ全体での生産体制の見直しや他社との協力関係の構築などにより、安定的に高稼働率を維持できる体制の構築を目指してまいります。

テラプローブは株主のみなさまのご支援に支えられ、今年10月1日に創業10周年を迎えます。これを機に毎年3月末時点で1単元(100株)以上を保有されている株主のみなさまに対する株主優待制度を導入いたします。また今年に限り、9月末時点で1単元以上を保有されている株主様を対象に、10周年記念株主優待も実施いたします。

今後も既存事業の拡充に加え新たなビジネスにも取り組むことで、企業価値の向上を図ってまいります。株主のみなさまにおかれましては、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長兼CEO

渡辺 雄一郎

*1 ISO/TS16949:自動車産業向け品質マネジメントシステム

*2 評価SDK:Software Development Kitの略。評価用ソフトウェア開発キット

連結決算ハイライト

メモリ事業について

メモリ事業におきましては、テスト時間の短縮が進んだことや主要顧客の生産量の減少などもあり、前年度に比べ売上高は減少したものの、減価償却費の減少や台湾子会社の改善などにより利益は増加いたしました。

これらの結果、当連結会計年度のメモリ事業の売上高は14,531百万円(前期比9.4%減)、セグメント利益は3,396百万円(前期比16.8%増)となりました。

システムLSI事業について

システムLSI事業のテスト受託におきましては、国内、台湾とも順調に増加いたしました。しかしながら、ウエハレベルパッケージ(WLP)・Bump受託におきましては、Bump受託が増加したものの、WLP受託は既存品の受託が低調に推移いたしました。

これらの結果、当連結会計年度におけるシステムLSI事業の売上高は6,498百万円(前期比15.1%増)、セグメント損益は853百万円の損失(前期は818百万円の損失)となりました。

連結財務諸表(要旨)

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	2014年3月末	2015年3月末
〈資産の部〉		
流動資産合計	13,820	14,366
固定資産合計	19,693	20,958
資産合計	33,514	35,324
〈負債の部〉		
流動負債合計	7,686	7,959
固定負債合計	3,156	3,773
負債合計	10,842	11,732
〈純資産の部〉		
資本金	11,823	11,823
資本剰余金	11,380	11,380
株主資本合計	20,206	19,877
純資産合計	22,671	23,591
負債純資産合計	33,514	35,324

連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	2013年度 (2013年4月1日～2014年3月31日)	2014年度 (2014年4月1日～2015年3月31日)
売上高	21,668	21,303
売上原価	18,732	17,676
売上総利益	2,935	3,627
販売費及び一般管理費	2,098	2,297
営業利益	837	1,329
営業外収益合計	174	179
営業外費用合計	229	203
経常利益	783	1,306
特別利益合計	489	53
特別損失合計	960	1,001
税金等調整前当期純利益	312	357
法人税等	18	357
少数株主利益	232	477
当期純利益	61	△477

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2013年度 (2013年4月1日～2014年3月31日)	2014年度 (2014年4月1日～2015年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,178	6,238
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,653	△6,597
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,757	△783
現金及び現金同等物の増減額(△減少)	1,839	△1,002
現金及び現金同等物の期末残高	7,882	6,880

売上高



営業利益・経常利益・当期純利益



純資産・総資産



特集

九州事業所から見る システムLSI事業の テストビジネスの取り組み



テラプローブは、DRAM等メモリ製品のテストを扱うメモリ事業、SoCやイメージセンサなど多様な半導体製品のテスト・開発受託、WLP等パッケージを扱うシステムLSI事業の2事業部で構成されています。システムLSI事業におけるテストビジネスは、熊本にある九州事業所を中心に国内、台湾で展開しています。

Q

九州事業所では開所から現在まで
どんな半導体をテストしてきたのですか？

A. 一言で言えば、メモリ製品以外の半導体のテストです。

2006年開所当初はデジタル家電向けのASIC※1やSoC※2のテストに始まり、2009年にイメージセンサ※3に参入して以来、アナログIC※4、PMIC※5も順次手掛けるようになりました。2014年には自動車産業向けマネジメントシステムISO/TS16949(2009年度版)の認証を国内及び台湾で取得し、非常に高い品質管理が求められる車載マイコンのテストも受託しています。



ISO/TS16949(2009年度版) 認証書

- ※1 【Application Specific Integrated Circuit】の略。ある特定の用途のために設計、製造される集積回路のこと。カスタムIC、カスタムチップなどとも呼ばれる。
- ※2 【System on a Chip】の略。1つの半導体チップ上に、メモリやプロセッサ、グラフィック処理などシステムの動作に必要な機能の全てを実装する。
- ※3 主にCMOS(相補性金属酸化膜半導体)を用いた、レンズから入った光を電気信号に変換する半導体(撮像素子)。
- ※4 音声、圧力、湿度、電気などの現実世界の信号を1と0のデジタル信号に変換する半導体。
- ※5 CPUやメモリを動かすための小さな電力を供給する半導体。



多様な半導体をテストするようになるまで、
ビジネスを拡大できた理由をお聞かせください。

A. 九州事業所の半導体テストへの継続的な取り組みと、技術力の蓄積を評価いただいた結果と考えています。

お客様からテストを委託いただくには、技術力や工程運営はもちろんのこと、非常に高い清浄度を求められるクリーンルームや、装置、治工具の維持・管理に至るまで、あらゆる項目で高い水準が求められます。

これらの課題を一つずつクリアしてきたことで、お客様の信頼を得られたのだと思います。



テラプローブ九州事業所のクリーンルーム内



システムLSI事業のテストビジネスの強みとは何ですか？

A. プログラム開発、お客様への提案、治工具設計などの技術力と高品質で効率的なオペレーションです。

長年培ってきた開発・技術力を有する国内と、世界の半導体生産の中心地である台湾の2拠点で工場を運営しており、その緊密な連携のもと、お客様の多様

なニーズに対し、フレキシブルな対応による最適なサービスの提供が可能なおことです。



システムLSI事業の2015年度の取り組みを教えてください。

A. 3つのテーマに取り組んでまいります。

半導体市場において、今後も車載向けやイメージセンサなどの着実な成長が見込まれております。この分野における地歩を固めることは当社の成長に不可欠であると考えており、培った技術やノウハウを生かして、右の3つのテーマに取り組んでまいります。

- ①車載製品の取り込み拡大
- ②CMOSイメージセンサの受託増加への対応
- ③テストプログラム開発、治工具開発の強化
これにより、生産能力及び生産効率の向上とコスト削減を推進し、利益の拡大を目指してまいります。

展示会への出展

テラプローブは様々な展示会に積極的に出展し、各種テストサービスとパッケージ、顔認証など先端技術の紹介を行っております。

2014/12/3~5

SEMICON Japan 2014(東京ビッグサイト)

「SEMICON Japan」は、世界最大級のマイクロエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会です。

当社はSEMICONで初めて開催された特別展World of IoT内にブースを出展しました。組み込みシステム向け顔認証ソフトウェア・ライブラリ「TeraFaces™」搭載デモンストレーションとして、顔認証搭載ドア開閉システムなどを紹介しました。



2015/1/14~16

第16回半導体パッケージング技術展(東京ビッグサイト)

「半導体パッケージング技術展」は、半導体、LED、パワーデバイス、MEMSデバイスなどのパッケージング技術に特化した専門展示会です。

当社のパッケージ技術であるWLP(Wafer Level Package)とファイナルテスト、テープ&リールを一貫して提供するターンキーサービスを紹介いたしました。



2015/5/13~15

第18回組み込みシステム※1開発技術展(東京ビッグサイト)

「組み込みシステム開発技術展」は、組み込みシステム開発に必要なハードウェア、ソフトウェア・コンポーネントを集めた専門展示会です。

当社は顔認証ソリューションの下記の3つのデモンストレーションと生体信号(脳波)の研究報告を実施しました。

【顔認証ソリューション】

- ①2015年3月よりサンプル受注を開始した世界最小、世界最速※2の「TeraFaces™」モジュールを応用したスマートカーのデモンストレーション
- ②Android OS に対応したスマート製品(Smart Glasses、電子伝言板)イメージのデモンストレーション
- ③スマートセキュリティ(監視カメラ)のデモンストレーション

※1 産業機器や家電製品などに内蔵される、特定の機能を実現するためのコンピュータシステム。

※2 2015年2月時点 当社調べ

【生体信号の研究報告】

脳波を用いたヒューマンインターフェースの研究報告



会社情報 / 株式情報

株式情報

2015年3月31日現在

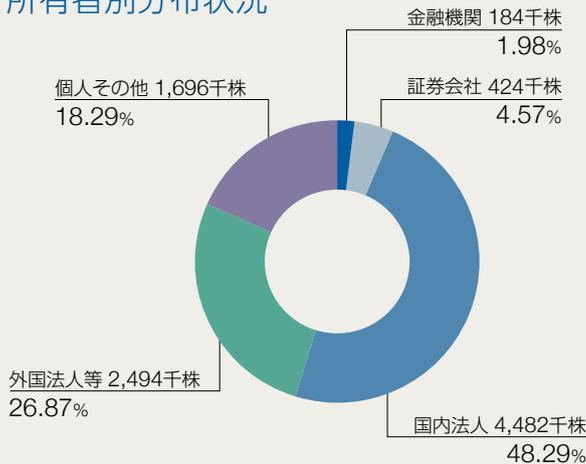
発行可能株式総数	30,000,000 株
発行済株式総数	9,282,500 株
株主数	2,410 名

大株主

株主名	持株数	(%)
マイクロンメモリ ジャパン株式会社	3,680,000	39.64
MSIP CLIENT SECURITIES	1,077,100	11.60
株式会社アドバンテスト	760,000	8.18
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	469,447	5.05
ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED	305,700	3.29
株式会社SBI証券	254,900	2.74
神林 忠弘	120,100	1.29
家島 秀樹	120,000	1.29
日本証券金融株式会社	97,800	1.05
BNYM SA/NV FOR BNYM CLIENT ACCOUNT MPCJ JAPAN	89,900	0.96

(注) 1. 持株比率は自己株式(104株)を控除して計算しております。
2. 持株比率は小数点第3位を切り捨てて表示しております。

所有者別分布状況



株主メモ

上場証券取引所	東京証券取引所 マザーズ
事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
株式の売買単位	100株
公告方法	公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL	http://www.teraprobe.com/
株主名簿管理人	三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先	☎0120-782-031
ホームページURL	http://www.smtb.jp/personal/agency/

会社概要

2015年3月31日現在

社名	株式会社テラプローブ (英文:Tera Probe, Inc.)
設立	2005年8月
資本金	11,823百万円
従業員数	410名(単体)、618名(連結)
事業内容	メモリ事業 DRAM等のメモリ製品のウエハテスト、ファイナルテスト、テストプログラム開発、WLP-Bumpの受託 システムLSI事業 SoC、イメージセンサ、マイコン等 各種半導体製品のウエハテスト、ファイナルテスト、テストプログラム開発、WLP-Bumpの受託 要素技術の研究/開発 最先端要素技術の研究、ソフトウェア製品開発/受託開発

事業拠点



役員状況 (2015年6月26日現在)

代表取締役社長	わたなべ ゆういちろう 渡辺 雄一郎	常勤監査役	ましこ たかゆき 増子 尚之
代表取締役副社長	こだいら ひろんど 小平 広人	監査役	ひがき おさむ 檜垣 修
取締役	よこやま つよし 横山 毅	監査役	うちこし ゆうすけ 打越 佑介
社外取締役	はぎわら としあき 萩原 俊明		
社外取締役	ふくだ たけひろ 福田 岳弘		
社外取締役	もりもと けんじ 森本 賢治		
社外取締役	もり なおき 森 直樹		

ホームページのご案内

当社では、株主・投資家のみなさまにプレスリリースや決算説明資料などのIR情報をホームページで公開しております。是非、ご覧ください。

【コーポレートサイト】



http://www.teraprobe.com/

【IRサイト】



http://www.teraprobe.com/ir/

株式会社テラプローブ

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-17
TEL:045-476-5711
ホームページURL http://www.teraprobe.com/



本誌は、FSC®認証紙と、植物性インキを使用しています。



株主優待制度を始めます

当社は、2015年10月1日の創業10周年を機に株主優待制度の導入及び10周年記念株主優待を実施いたします。当社の知名度を向上させ、株主・投資家のみなさまに当社株式への認識を深めていただき、より多くの株主様に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的に、株主優待制度の導入及び10周年記念株主優待を実施することといたしました。

対象となる方

毎年3月31日現在の株主名簿に記録された、**1単元(100株)以上**を保有されている株主様

優待内容

QUOカード(クオカード)
1,000円分

発送時期

毎年6月下旬ごろ

実施開始時期

2016年3月31日現在の株主名簿に記録された、**1単元(100株)以上**を保有されている株主様を対象として開始いたします。

10周年記念株主優待

2015年9月30日現在の株主名簿に記録された、**1単元(100株)以上**を保有されている株主様に上記優待制度と同様の内容で12月初旬ごろの贈呈を予定しております。

第10期定時株主総会が以下のとおり開催されました。

1. 開催日時 平成27年6月26日(金曜日) 午前10時
2. 開催場所 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目6番15号 新横浜グレイスホテル4階シャーロット
3. 内 容
 - 報告事項
 1. 第10期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第10期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件
 - 決議事項
 - 第1号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に森 直樹氏が選任され、就任いたしました。
 - 第2号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に清水 宏樹氏が選任され、就任いたしました。